

证券代码：002618

证券简称：丹邦科技

公告编号：2013-046

深圳丹邦科技股份有限公司

关于向全资子公司广东丹邦科技有限公司增资的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据2013年3月27日召开的2013年第一次临时股东大会授权及公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关文件，公司非公开发行募投项目“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”拟通过对全资子公司广东丹邦科技有限公司（以下简称：“广东丹邦”）增资的方式进行实施。

公司本次对广东丹邦的增资不涉及关联交易。根据2013年3月27日召开的2013年第一次临时股东大会的授权，由董事会办理募集资金到位后对本次募投项目实施主体广东丹邦的增资事项。故此事项无需再提交股东大会审议。

一、增资情况概述

根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”的募集资金投资总额为59,996.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为58,096.816万元。为了非公开发行募集资金投资项目的后期建设，公司此次拟投入募集资金对广东丹邦进行增资，增资金额为人民币58,096.816万元，其中2,000.00万元增加注册资本（实收资本），56,096.816万元计入资本公积，广东丹邦另一股东丹邦科技（香港）有限公司（为公司全资子公司）本次不增资。

本次增资实施后，广东丹邦注册资本为15,000.00万元，公司通过直接和间接方式合计持有广东丹邦100%股权。

二、增资主体情况

公司名称：广东丹邦科技有限公司

法定代表人：刘萍

注册地址：东莞市松山湖科技产业园区北部工业城C区BC-18

注册资本：13,000万元（实收资本13,000万元）

成立时间：2009年8月25日

经营范围：设立研发机构, 研究、开发新型电子元器件产品，生产和销售新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高密度互连积层板、多层挠性板、封装基板），并提供上述产品的技术咨询及相关配套业务。

股权结构：公司及全资子公司丹邦科技（香港）有限公司分别持有广东丹邦90.38%、9.62%股权，公司通过直接和间接方式合计持有广东丹邦100%股权。

三、增资目的及资金来源

本次增资广东丹邦是确保非公开发行募集资金投资项目稳步实施的必要条件，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增强资本实力和业务发展能力，进一步改善财务结构，降低财务费用，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益，是可行也是必要的。

本次增资资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。

四、增资对公司产生的影响

本次增资的实施，有利于广东丹邦尽快投入非公开发行募集资金投资项目建设，提升公司整体生产能力，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

五、增资后募集资金的管理

此次增资所涉募集资金，广东丹邦将严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，在银行开设募集资金专项账户进行管理。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2013年10月29日